

国产替代加速，半导体龙头 H1 业绩增速强劲

相关研究：

- 1.《供给短缺叠加需求上行，助推晶圆代工龙头业绩增长》
2021.05.28
- 2.《“缺芯”困局助推国产化替代加速，我国半导体产业或迎机会窗口》
2021.06.29
- 3.《“缺芯”+政策支持，助推国产化替代加速》
2021.08.04

行业评级：增持

近十二个月行业表现



%	1 个月	3 个月	12 个月
相对收益	10.5	43.5	37.9
绝对收益	3.8	35.7	38.5

注：相对收益与沪深 300 相比

分析师：王攀

证书编号：S0500520120001

Tel: (8621) 38784580-8941

Email: wangpan2@xcsc.com

联系人：王文瑞

Tel: (8621) 38784580-8817

Email: wangwr2@xcsc.com

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路
958号华能联合大厦5层湘财证券研
究所

核心要点：

□ 近两周（8月09日-8月20日），申万半导体板块回调，下跌6.08%

近两周（8月09日-8月20日），基于8月16日发布的国内7月经济数据未达预期叠加行业监管性政策频发，市场预期美联储加息或提速，中报业绩红利释放基本完成等多因素的影响，大盘及电子行业相关指数呈现回落态势；沪深300下跌6.08%，上证综指下跌0.89%，深证成指下跌3.87%，科创50下跌3.63%。申万半导体行业指数下跌6.08%，回调较为显著。近2周半导体行业估值呈回调态势，截至2021年8月20日半导体行业估值91.45（TTM，剔除负值）。受内外部宏观经济政策，市场需求、多家上市企业推进增发再融资等因素扰动，预期中短期半导体板块呈震荡态势。

□ 半导体行业上市公司中期业绩预喜，多公司推进增发再融资

2021年度上半期，**华虹半导体**实现归属于上市公司股东的净利润4.98亿元，同比增长102.26%；**华润微**实现归母净利润10.68亿元，同比增长164.86%；**晶丰明源**实现归母净利润3.36亿元，同比增长3457%；**士兰微**实现归母净利润4.31亿元，同比增长1306.5%，业绩创历史新高；**中颖电子**实现归母净利润1.53亿元，同比增长62.62%；**长电科技**实现归母净利润13.22亿元，同比增长260.97%。

半导体板块多家上市公司推进定增再融资，立昂微、北京君正再融资方案获批，立昂微预计募集资金52亿元，北京君正预计募集资金13.07亿元；利杨芯片、斯达半导发布再融资预案。

□ 英国监管机构初步否决英伟达收购英国芯片设计公司ARM的计划；IP、指令集架构作为芯片设计的支撑产业，Arm的运营独立性是下游客户业务安全性的重要保障；ARM被收购事件增强了业界对RISC-V的关注，Risc-V生态建设提速或利好国内芯片产业

IP、指令集架构作为芯片设计的支撑产业，Arm保持运营独立性意义重大。

安全问题引发国内芯片开发企业积极投身开源指令集Risc-V的开发，ARM被收购事件增强了业界对RISC-V的关注，Risc-V生态建设提速或利好国内芯片产业。

□ 投资建议

建议持续关注半导体行业。2021年度芯片市场需求强劲，助推半导体龙头企业营收上行；国家政策支持叠加国产化替代加速，加快国内半导体产业技术研发进展，长期利好产业发展。给予半导体行业“增持”评级。

□ 风险提示

行业竞争加剧，晶圆代工企业产能扩产不及预期；市场需求不及预期，国内半导体企业技术研发进展不及预期。

1 半导体行业行情回顾

1.1 多因素扰动，半导体板块呈震荡态势

近两周（8月09日-8月20日），基于8月16日发布的国内7月经济数据未达预期叠加行业监管性政策频发，市场预期美联储加息或提速，中报业绩红利释放基本完成等多因素的影响，大盘及电子行业相关指数呈现回落态势；沪深300下跌6.08%，上证综指下跌0.89%，深证成指下跌3.87%，科创50下跌3.63%。申万电子行业指数下跌4.85%；申万半导体行业指数下跌6.08%，回调较为显著，在所有二级行业中排序96/104。

图 1：半导体行业上周主要指数表现回顾（截至 8.20）

	半导体（申万） （%）	电子（申万）	沪深300	上证综指	深证成指	科创50
上周	-6.08	-4.85	-3.09	-0.89	-3.87	-3.63
年初至今	36.55	10.20	-8.48	-1.32	-1.50	9.77

资料来源：wind、湘财证券研究所

上周申万半导体子板块中集成电路板块回调6.43%，分立器件板块回调5.95%，半导体材料板块回调3.98%。

根据我们的统计，受宏观经济、部分资金借中报利好兑现利润及中国电信IPO吸筹等因素影响，近2周电子行业、半导体行业估值呈回调态势。截至2021年8月20日，电子行业估值为42.67倍（TTM，剔除负值），半导体行业估值91.45（TTM，剔除负值）。受内外部宏观经济政策，市场需求、多家上市企业推进增发再融资等因素扰动，预期中短期半导体板块持续震荡；中长期受益于新技术5G、物联网、智能驾驶等新需求带动，国产化替代持续推进等因素，板块走强的趋势不变。

图 2: 申万电子行业&半导体行业 5 年 PE(TTM)水平变化 (截至 8.20)



图 3: 近 5 年电子/半导体相对沪深 300 估值溢价率 (截至 8.20)



资料来源: wind、湘财证券研究所

资料来源: wind、湘财证券研究所

半导体行业 (剔除*ST 盈方, 大港股份) 71 家上市公司中, 16 家上涨, 55 家下跌; 其中上周涨幅前五位的个股为帝科股份 (35.26%)、明微电子 (14.94%)、博通集成 (12.22%)、睿创微纳 (11.49%) 和紫光国微 (10.35%), 跌幅后五位的个股为清溢光电 (-15.34%)、聚辰股份 (-15.73%)、韦尔股份 (-16.4%)、芯原股份 (-16.76%) 和国科微 (-18.41%)。

图 4: 半月度半导体行业上市公司涨幅前 5&跌幅前 5 (截至 8.20)

半导体板块个股涨幅前 5				半导体板块个股跌幅前 5			
证券简称	收盘价 (元)	2 周涨幅 (%)	市值 (亿元)	证券简称	收盘价 (元)	2 周跌幅 (%)	市值 (亿元)
帝科股份	85.23	35.26	85.23	清溢光电	18.38	-15.34	49.04
明微电子	316.00	14.94	235.00	聚辰股份	48.91	-15.73	59.10
博通集成	82.63	12.22	124.30	韦尔股份	258.30	-16.40	2243.54
睿创微纳	120.41	11.49	535.82	芯原股份-U	80.69	-16.76	395.54
紫光国微	215.95	10.35	1310.42	国科微	138.69	-18.41	250.08

资料来源: wind、湘财证券研究所

1.2 全球重要电子行业市场指数微幅回落

全球半导体行业仍位于景气区间, 受市场对于存储类芯片景气度的可持续性存疑影响, 费城半导体指数和台湾半导体指数近两周呈回调态势。截止 8 月 20 日, 费城半导体指数收于 3256.5 点, 年同比上涨 49%, 周同比回落 2.4%。台湾半导体指数收于 385.88 点, 年同比上涨 42%, 周同比回落 4.6%。

图 5：费城半导体指数（截至 8.20）

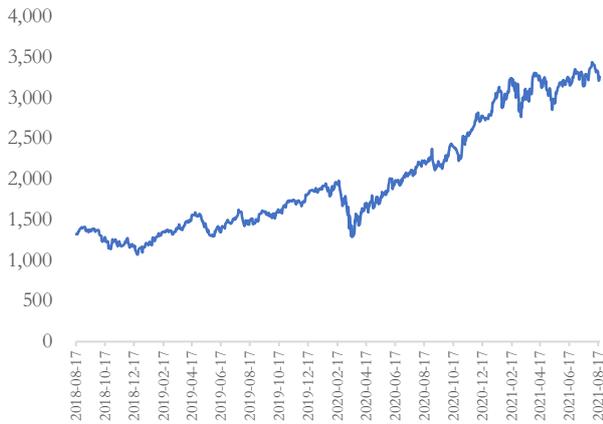
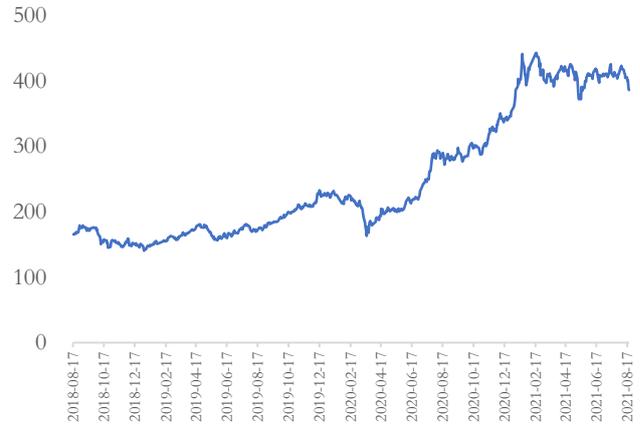


图 6：台湾半导体指数（截至 8.20）



资料来源：wind、湘财证券研究所

资料来源：wind、湘财证券研究所

2 上市公司 2021 年中期业绩公告

【寒武纪】8月11日，寒武纪公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度亏损3.91亿元，净利润同比去年同期减少。公司盈利下行系为进一步推进“云边端”产业布局，扩大产品线，加大研发投入和人才引进力度所致；其中研发投入为4.16亿元，较上年同期增加1.38亿元，为激励人才所支付的股份支付费用较上年同期增加7685.62万元。

【华虹半导体】8月12日，华虹半导体公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达6.51亿美元，同比增长52%，主要系受晶圆量价齐升提振。公司约当8英寸晶圆产能持续提升，公司月产能由20.1万片提升至26.8万片，受益于产能利用率提升及晶圆平均销售价格提升公司半年度毛利率为24.2%，同比增长0.6个百分点。公司半年度归母净利润为4.98亿元，同比增长102.26%；涨幅显著。

【聚辰股份】8月16日，聚辰股份公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达约2.64亿元，同比增长21.24%。公司归母净利润为6575.2万元，同比增长41.23%；扣非后归母净利润为3073.6万元，同比下滑23.09%。公司营收下游需求逐步回暖，公司利润下滑系智能手机摄像头EEPROM产品平均单价降低、研发支出增加等因素所致。

【晶晨股份】8月16日，晶晨股份公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达约20.02亿元，同比增长111.81%。公司归母净利润为2.5亿元，同比增长499.16%；扣非后归母净利润约为2.33亿元，同比增长392.99%；公司营收上涨主要受益于下游需求回暖，公司产品销售量价

齐升。同时公司对产品结构进行了优化，提高了智能 LED 照明驱动芯片的交付优先级，公司智能 LED 电源驱动芯片占整体销售收入比例上升。

【华润微】8月17日，华润微公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达约44.55亿元，同比增长45.43%。公司归母净利润约为10.68亿元，同比增长164.86%；扣非后归母净利润约为10.15亿元，同比增长194.42；公司营收上涨主要系因市场景气度较高，公司产品销量上行，整体产能利用率较高，带动各事业群营业收入增长。

【晶丰明源】8月17日，晶丰明源公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达约10.65亿元，同比增长177.19%。公司归母净利润为3.36亿元，同比增长3457%；扣非后归母净利润约为2.74亿元，实现扭亏为盈；公司营收上涨主要受益于下游需求回暖，营业收入增长产生的规模效应进一步带动公司盈利能力提升。

【士兰微】8月17日，士兰微公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达约33.08亿元，同比增长94.05%。公司归母净利润为4.31亿元，同比增长1306.52%；扣非后归母净利润约为4.02亿元，同比增长17998%；公司业绩创历史新高。公司盈利能力显著上行系受益于：

(1) 子公司士兰集昕公司8英寸芯片生产线保持较高水平的产出，芯片产量大幅提升，产品综合毛利率提高至18.35%。

(2) 子公司士兰明芯公司LED芯片生产线基本处于满负荷生产状态，LED芯片产量大幅提升，产品综合毛利率提高至6.87%，亏损大幅度减少。

(3) 公司集成电路和分立器件产品销量较去年同期大幅度增长，产品毛利率提高至23.94%，营业利润大幅度增长。

【中颖电子】8月19日，中颖电子公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达约6.86亿元，同比增长50.78%。公司归母净利润为1.53亿元，同比增长62.62%；扣非后归母净利润约为1.43亿元，同比增长72.4%；公司半年度净利润率为22.2%，同比上升2.8个百分点。公司营收上涨主要受益于下游客户需求强劲，市场供需紧张提升公司产品销量，公司AMOLED显示驱动芯片及锂电池管理芯片的销售额同比呈现倍数级的增长。

【银河微电】8月19日，银河微电公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达约4.05亿元，同比增长53.59%。公司归母净利润为5784.6万元，同比增长88.39%；扣非后归母净利润约为5542万元，同比增长128.7%。公司业绩上行系2021年公司加快扩大产能，打造高效产能利用，提高生产效率，积极扩大市场份额。

【敏芯股份】8月19日，敏芯股份公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达约1.87亿元，同比增长40.17%。公司归母净利润为1021.8万元，同比下滑40.05%；扣非后归母净利润为497.2万元，同比下滑68.76%。公司营收上行主要系产品销量提升，公司利润下滑系本期新增股份支付所致。剔除股份支付的影响则公司归母净利润和扣非后归母净利润分别为2580.13万元和2055.61万元，比去年同期增长51.39%和29.15%。

【全志科技】8月19日，全志科技公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达约10.48亿元，同比增长75.07%。公司归母净利润为2.42亿元，同比增长181.44%；扣非后归母净利润为2.02亿元，同比增长179.1%。公司盈利上行主要系智能硬件、智能车载等产品量价齐升，公司智能终端应用处理器芯片销售额同比增长77.59%。

【扬杰科技】8月19日，扬杰科技公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达约20.8亿元，同比增长82.93%，主要系功率半导体国产化替代加速助推公司市场份额增大。公司归母净利润为3.44亿元，同比增长138.57%；扣非后归母净利润为3.32亿元，同比增长131.1%。公司半年度销售净利率为17.7%，同比提高约4.9个百分点。

【捷捷微电】8月19日，捷捷微电公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达约8.52亿元，同比增长109.03%。公司归母净利润为23955.3万元，同比增长105.21%；扣非后归母净利润为22632.9万元，同比增长100.69%。公司半年度销售净利率为17.7%，同比提高约4.9个百分点。

【长电科技】8月19日，长电科技公告披露2021年半年度业绩，公司2021年半年度营收达约138.19亿元，同比增长15.39%。公司归母净利润为13.22亿元，同比增长260.97%；扣非后归母净利润为9.38亿元，同比增长217.62%。公司业绩上行主要源自于近年来公司聚焦高附加值、快速成长的市场热点应用，同时，国内外各工厂持续加大运营管理能力的提升，积极调整技术和产品结构，进而持续推动盈利能力提升。

图 7：上市公司 2021 年中期业绩梳理

	归属于母公司/上市公司股东的净利润	同比涨幅	注
寒武纪	亏损 3.91 亿元	-	
华虹半导体	4.98 亿元	102.26%	
聚辰股份	6575.2 万元	41.23%	
晶晨股份	2.5 亿元	499.16%	
华润微	10.68 亿元	164.86%	
晶丰明源	3.36 亿元	3457%	
士兰微	4.31 亿元	1306.5%	
中颖电子	1.53 亿元	62.62%	
银河微电	5784.6 万元	88.39%	
敏芯股份	1021.8 万元	-40.05%	股份支付影响净利润
全志科技	2.42 亿元	181.44%	
扬杰科技	3.44 亿元	138.57%	
捷捷微电	2.39 亿元	105.21%	
长电科技	13.22 亿元	260.97%	

资料来源：wind，湘财证券研究所

3 半导体行业事件点评

路透社 8 月 20 日报道，英伟达计划以 400 亿美元收购英国芯片设计公司 ARM 的计划在周五遇到了重大障碍，英国竞争和市场管理局(CMA)表示在对英伟达收购 ARM 一案的初步调查后，认为该收购行为有限制竞争的垄断担忧，将对其进行第二阶段调查。

IP、指令集架构作为芯片设计的支撑产业，Arm 保持运营独立性意义重大：IP 核是具有知识产权的、功能具体、接口规范的可以在多个集成电路中重复使用的功能模块，是实现系统芯片的基本构件；芯片设计企业可通过获取授权缩短自身的研发周期、实现较快地推陈出新，有效降低研发成本、获取更高的收益。IP 核/架构授权方则通过获取 IP 授权费和版税（版税为单颗芯片售价的 1-2%，按销量收取）实现盈利。ARM 架构（Advanced RISC Machine）具有高性能，低功耗，小体积，保持有效的扩展更新等特征，叠加与谷歌已合作搭建了成熟的 AA 生态系统，其架构及 IP 核成为大量移动设备处理器的基础，Arm 架构芯片在手机市场的市占率稳定高于 90%；高通骁龙、Apple A 系列、华为麒麟芯片、三星 Exynos 等各大移动设备芯片皆采用 ARM 的架构。**Arm 的运营独立性是下游客户业务安全性的重要保障。**

图 8: ARM 授权模式梳理

授权方式	简介	特点	应用范围	客户研发能力要求
架构 / 指令集层级授权	允许客户 ARM 架构进行大幅度改造, 对 ARM 指令集进行扩展或缩减; 为自己独有的系统、应用和生态做优化。(如苹果 swift 架构)	灵活性非常强, 据此可自研 CPU; 授权费用高昂, 获取难度极高 (典型客户: 苹果, 三星, 华为, 高通等)	——	最高, 且研发成本高昂
IP 核层级授权				
软核层级	用硬件描述语言(HDL)设计的独立功能的电路模块; 以 HDL 文本形式交付	灵活性高、可移植性强, 允许用户自配置; 但不得二次销售优化过的 IP, 可以任意营销其最终制品(包含芯片、开发样板、完整系统等)	多	高
固核层级	完成了 IP 软核设计+门级电路综合和时序仿真等; 以门级电路网表的形式交付	部分功能可修改, 具备一定的灵活性	较多	较高
硬核层级	已有固定的拓扑布局和具体工艺, 并已经过工艺验证, 具有可保证的性能; 以电路物理结构掩模版图和全套工艺文件的形式交付	可以直接测试和生产, 不能更改设计及工艺, 灵活性低	一般	一般

资料来源: 公开资料、湘财证券研究所

安全问题引发国内芯片开发企业积极投身开源指令集 Risc-V 的开发, ARM 被收购事件增强了业界对 RISC-V 的关注, Risc-V 生态建设提速或利好国内芯片产业: 中美贸易摩擦国内科技的底层技术安全问题获得极大关注, 基于 ARM 的指令集及 IP 核都需要通过授权获取, 可延续性存在不确定性; 国内芯片开发企业基于安全问题及政策引导的推动向投身具备自主可控性的开源指令集 Risc-V 的开发及生态的建设, Risc-V 作为后发技术尚处于商业化的初期, 暂无垄断性企业出现, 国内半导体企业或可获得较强的话语权。RISC-V 于 2010 年诞生, 与 ARM 架构都源自 1980 年代的精简指令计算机 RISC, 在新兴技术领域与 Arm 处于同一起跑线上、尚无明显的优劣势, 基于其开源的特性 Risc-V 有望在新兴技术领域击败 Arm; 以阿里平头哥、华为、中科院计算机所、紫光展锐等为代表的国内众多机构积极投身于 RISC-V 的扩展研发及生态建设, 且作为 risc-v 基金会成员协同基金会积极推进基础指令集标准的建立。ARM 被收购事件增强了业界对 RISC-V 的关注, RISC-V 基金会已经聚集了特斯拉、谷歌、高通、三星、华为、西部数据等众多科技巨头, Mips 指令集的母公司 Wave Computing 也转投 RISC-V 研发阵营, 基金会成员已达 2000 余家, 分布于 70 多个国家; 参与企业的不断增多利好 Risc-V 生态系统建设及商业化的推进。

4 半导体行业周动态汇总

4.1 半导体行业技术新动态

【联发科发布天玑 920 和天玑 810 5G 移动芯片】

8月11日，联发科发布天玑系列5G移动芯片的两款新品：天玑920和天玑810。在性能和影像呈现、显示技术等方面有显著优化。天玑920相比天玑900性能有所提升；天玑810是天玑800的迭代产品，性能弱于2020年发布的天玑820。采用联发科天玑920和天玑810的终端设备预计将于2021年第三季度在全球上市，这两款芯片目标客户为市场上中低端价位手机。

图 9：联发科天玑移动芯片性能简介

	天玑 920	天玑 810
性能配置	八核，2 个 A78 主频 2.5GHz 的大核心，6 个 A55 主频 2.0GHz 小核心；支持 LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存	八核，2 个主频为 2.4GHz 的 Arm Cortex-A76 核心
芯片制程	7nm	7nm
影像	支持 1.08 亿像素四摄组合，相较于 810 硬件配置更优	支持 6400 万像素的摄像头
游戏引擎	支持 MediaTek HyperEngine 3.0 游戏引擎	支持 MediaTek HyperEngine 2.0 游戏引擎
显示性能	最高分辨率 2520×1080，刷新率 120Hz，并特别支持智能刷新率显示	支持 2520×1080 分辨率、120Hz 高刷

资料来源：公开资料，湘财证券研究所

4.2 半导体行业新闻

【2021H1 中国集成电路产业销售额达 4102.9 亿元，同比增长 15.9%】全球半导体观察

8月13日，中国半导体行业协会官网发布了2021年1-6月中国集成电路产业运行情况，1-6月中国集成电路产业销售额为4102.9亿元，同比增长15.9%，增速比一季度略有下降。其中，设计业同比增长18.5%，销售额为1766.4亿元；制造业同比增长21.3%，销售额为1171.8亿元；封装测试业同比增长7.6%，销售额1164.7亿元。我国集成电路产业继续保持稳定增长态势。

【上海临港“十四五”规划：到 2025 年，集成电路产业规模突破 1000 亿元】 界面新闻

8 月 12 日，上海市政府发布关于印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》，规划指出到 2025 年，临港新片区的集成电路产业规模将突破 1000 亿元，芯片制造、装备材料主导地位进一步加强，芯片设计、封装测试形成规模化集聚。到 2035 年，临港新片区将构建起高水平产业生态，成为具有全球影响力的“东方芯港”。在集成电路高质量发展方面，临港新片区园区集成电路产业投资强度将达到 1500 万元/亩，产出强度 1500 万元/亩。

【马来西亚疫情加重，半导体封测代工产能受冲击】 每日经济新闻

8 月 18 日，马来西亚卫生部通报称，截至当日中午 12 时，该国过去 24 小时新增新冠肺炎确诊病例 22242 例，创下疫情暴发以来新高；全国封锁措施被无限期延长。半导体厂商仍遵守当地的防疫管制，仅保留六成员工，产能受到冲击。马来西亚是全球被动元器件和半导体封测的重镇，其中半导体全球市占高达 13%，此举继续影响全球半导体市场的供需关系。

【台积电发布 7 月营收数据报告，同比增长 17.5%】 wind

8 月 10 日，台积电发布 7 月运营数据，公司 7 月合并营收为 1245.58 亿新台币，同比增长 17.5%；累计 2021 年 1-7 月公司营收达 8591.13 亿元，同比增长 18.1%，营收受市场驱动保持稳定高增长态势。

【深圳哈勃投资光刻胶生产企业徐州博康】 全球半导体观察

8 月 10 日，徐州博康信息化学品有限公司完成工商信息变更登记，公司获华为控股的深圳哈勃投资；徐州博康实现了从单体、光刻胶专用树脂、光酸剂及最终产品光刻胶的国产化自主可控的供应链，产品线覆盖 193nm/248nm 光刻胶单体、193nm/248nm 光刻胶、G 线/I 线光刻胶、电子束光刻胶等产品，产品广泛应用于 IC 集成电路制造、IC 后段封装、化合物半导体、分立器件、电子束等。

4.3 上市公司动态

【立昂微】8 月 9 日晚间，立昂微公告称公司再融资方案获批，公司拟通过非公开发行的方式向不超过 35 名的特定投资者增发股份 12017.4 万股，预计募集资金 52 亿元。募集资金拟投资项目计划如下图：

图 10：立昂微募集资金用途列示

项目名称	建设地点	投资金额 (亿元)	使用募集资金 (亿元)
年产 180 万片集成电路 用 12 英寸硅片	衢州	34.6	22.88
年产 72 万片 6 英寸功率 半导体芯片技术改造项 目	杭州	8.03	7.84
年产 240 万片 6 英寸硅外 延片技术改造项目	衢州	6.61	6.28
补充流动资金		15	15
合计		64.24	52

资料来源：立昂微，湘财证券研究所

【芯原股份】8 月 10 日晚间，芯原股份发布非公开发行限售股上市流通的公告；公司首次公开发行战略配售限售股及限售股合计约 15582.1 万股解禁上市流通，占公司截至 2021 年 8 月 10 日总股本的 32.4%。限售股于 2021 年 8 月 18 日上市流通。

【晶方科技】8 月 9 日晚间，晶方科技发布关于公司控股产业基金投资以色列第三代半导体领域 GaN (氮化镓) 器件设计公司 VisIC 公司的公告，晶方产业基金拟出资 1,000 万美金投资 Visic 公司，交易完成后晶方产业基金将持有 VisIC 公司 7.94% 的股权。VisIC 公司 Ness Ziona 是第三代半导体领域 GaN (氮化镓) 器件的全球领先者申请布局了 GaN (氮化镓) 技术的关键专利，在此基础上成功开发了氮化镓基大功率晶体管和模块，其高效可靠的产品可广泛使用于电能转换、快速充电、射频和功率器件等应用领域，现处于市场推广期。

【江丰电子】8 月 9 日晚间，江丰电子发布可转债发行公告，公司可转债发行规模为人民币 5.16 亿元，公司募集资金用途如下：

图 11：江丰电子募集资金用途列示

项目名称	投资金额 (亿元)	使用募集资金 (亿元)
惠州基地平板显示用高纯金属靶材及 部件建设项目	1.75	1.19
武汉基地平板显示用高纯金属靶材及 部件建设项目	3.03	2.46
补充流动资金/偿还银行贷款	1.51	1.51
合计	6.29	5.16

资料来源：江丰电子，湘财证券研究所

【利扬芯片】8月11日晚间，利扬芯片发布定增预案，公司拟向特定对象发行约2728万股，拟融资额约为13.65亿元。募集资金拟投资项目计划如下图：

图 12：利扬芯片募集资金用途列示

项目名称	投资金额 (亿元)	使用募集资金 (亿元)
东城利扬芯片集成电路测试项目	13.15	13.15
补充流动资金	0.5	0.5
合计	13.65	13.64

资料来源：利扬芯片，湘财证券研究所

【晶瑞电材】8月11日晚间，晶瑞电材发布可转债发行公告，公司可转债发行规模为人民币5.23亿元，公司募集资金用途如下：

图 13：晶瑞电材募集资金用途列示

项目名称	投资金额 (亿元)	使用募集资金 (亿元)
集成电路制造用高端光刻胶研发项目	4.88	3.13
阳恒化工年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目	1.87	0.67
补充流动资金/偿还银行贷款	1.43	1.43
合计	8.18	5.23

资料来源：晶瑞电材，湘财证券研究所

【斯达半导】8月15日晚间，斯达半导公告发布公司再融资预案，公司拟通过非公开发行的方式向不超过35名的特定投资者增发股份1600万股，预计募集资金35亿元。募集资金拟投资项目计划如下图：

图 14：斯达半导募集资金用途列示

项目名称	投资金额 (亿元)	使用募集资金 (亿元)
高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目	15	15
SiC芯片研发及产业化项目	5	5
功率半导体模块生产线自动化改造项目	7	7
补充流动资金	8	8
合计	35	35

资料来源：斯达半导，湘财证券研究所

【北京君正】8月16日晚间，北京君正公告称公司再融资方案获批，公司拟通过非公开发行的方式向不超过 35 名的特定投资者增发股份 14069.32 万股，预计募集资金 130672 万元。募集资金拟投资项目计划如下图：

图 15：北京君正募集资金用途列示

项目名称	投资金额 (亿元)	使用募集资金 (亿元)
嵌入式 MPU 系列芯片的研发与产业化项目	3.46	2.11
智能视频系列芯片的研发与产业化项目	5.6	3.62
车载 LED 照明系列芯片的研发与产业化项目	3.56	1.75
车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目	4.22	2.37
补充流动资金	3.2	3.2
合计	20.04	13.07

资料来源：北京君正，湘财证券研究所

5 投资建议

建议持续关注半导体行业。2021 年度芯片市场需求强劲，助推半导体龙头企业营收上行；国家政策支持叠加国产化替代加速，加快国内半导体产业技术研发进展，长期利好产业发展。给予半导体行业“增持”评级。

6 风险提示

行业竞争加剧，晶圆代工企业产能扩产不及预期；市场需求不及预期，国内半导体企业技术研发进展不及预期。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职、公正公平准则出具本报告。本报告准确清晰地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

湘财证券投资评级体系（市场比较基准为沪深 300 指数）

- 买入：**未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15% 以上；
- 增持：**未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 至 15%；
- 中性：**未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5% 至 5%；
- 减持：**未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5% 以上；
- 卖出：**未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15% 以上。

重要声明

湘财证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。

本研究报告仅供湘财证券股份有限公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告由湘财证券股份有限公司研究所编写，以合法地获得尽可能可靠、准确、完整的信息为基础，但对上述信息的来源、准确性及完整性不做任何保证。湘财证券研究所将随时补充、修订或更新有关信息，但未必发布。

在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见仅供参考，并不构成所述证券买卖的出价或征价。本公司及其关联机构、雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。投资者应明白并理解投资证券及投资产品的目的和当中的风险。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。

在法律允许的情况下，我公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告版权仅为湘财证券股份有限公司所有。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“湘财证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。